

证券代码：688347

证券简称：华虹宏力

华虹宏力半导体有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他_____
参与对象	华泰证券、中信证券、国信证券、盛博、大和证券、中信里昂、 东方证券及其他通过电话或网络方式参与华虹宏力半导体 2026 年第二季度业绩说明会的广大机构与个人投资者。
时间	2026 年 8 月 13 日 17: 00
地点	电话/网络会议 (https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php)
上市公司出席人员	白鹏 董事会主席、总裁兼执行董事 王鼎 执行副总裁兼首席财务官 钱蕾 董办部长
公司介绍	华虹宏力半导体有限公司（A 股简称：华虹宏力，688347；港股简称：华虹宏力，01347）（“本公司”）是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先进“特色 IC + Power Discrete”的发展战略，为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等特色工艺技术的持续创新，有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用，其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员，而华虹集团是中国拥有“8 英寸 + 12 英寸”先进集成电路制造主流工艺技术的产业集团。 本公司在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂，另在无锡高新技术产业开发区内建有两座全球领先的 12 英寸特色工艺晶圆厂，其中之一是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。 如欲取得更多公司相关资料，请浏览：www.huahonggrace.com。
投资者关系活动主要内容	总裁致辞

	华虹宏力董事会主席兼总裁白鹏博士对公司二零二六年第二季度业绩评论道： “华虹宏力二零二六年第二季度经营表现持续改善，盈利能力进一步提升。销售收入创历史新高，达 7.175 亿美元，同比增长 26.8%；毛利率为 16.5%，同比上升 5.6 个百分点。两项指标均优于指引，并均实现环比提升。母公司拥有人应占利润 3,860 万美元，同比及环比亦大幅增长。二季度，公司保持高产能利用率，各工艺技术平台均实现增长，其中独立式和嵌入式非易失性存储器产品表现尤为突出。产品量价齐升，促进公司经营业绩改善。” 白总继续表示：“自年初以来，人工智能持续驱动全球半导体行业需求增长，相关需求最先在存储器芯片产品中体现，并逐步扩展至与人工智能应用相关的逻辑和模拟芯片产品。作为服务于广泛终端市场的特色工艺晶圆代工企业，公司业务已明显受益于人工智能浪潮带来的积极影响。同时，我们也看到，不同终端细分市场的需求强度和持续性仍存在分化。面对快速演变的行业格局，公司坚持稳步扩充产能、持续升级特色工艺技术并不断优化产能配置和产品组合的战略，把握新的增长机遇，推动经营业绩持续改善。华虹宏力近日已获得中国证券监督管理委员会对华力微收购事项的注册批复。资产整合后，将进一步强化公司技术组合，提升运营规模效应并改善盈利能力，为公司未来发展注入新的动力。” 财务摘要 二零二六年第二季度主要财务指标（未经审核） ● 销售收入创历史新高，达 7.175 亿美元，同比增长 26.8%，环比增长 8.6%。 ● 毛利率 16.5%，同比上升 5.6 个百分点，环比上升 3.5 个百分点。 ● 母公司拥有人应占利润 3,860 万美元，同比上升 385.9%，环比上升 84.6%。 二零二六年第三季度指引 ● 我们预计销售收入约在 7.7 亿美元至 7.8 亿美元之间。 ● 我们预计毛利率约在 16%至 18%之间。 问答环节 1. 本季度平均销售价格环比增长了 3%。请问，推动 ASP 增长的因素是什么？是定价变化，还是产品组合变化？您如何看待今年下半年及更长期的 ASP 走势？
--	--

	答：正如大家所知，本行业的价格由市场决定，本质上取决于供需平衡。自年初以来，我们看到需求不断上升，供需平衡正转向供应偏紧。 因此，价格的上涨主要集中在 MCU、存储器等领域，这些领域与 AI 应用的关联度更高。消费领域也存在需求，但 AI 带来的需求机会可能更为显著，这也是供需关系转向需求增强、供应趋紧的原因。 此外，部分产品的需求已明确超出我们的供应能力；目前收到的订单量约为产能的 1.5 至 2 倍。因此，我们正尽一切可能优化产能结构，努力增加各类产品的产出。当前产能利用率基本已达到 100%，需要依靠新产能的释放、柔性管理和创新来挤出更多产能。 至于未来价格，关键在于本轮需求增长能够持续多久，业内仍有较多讨论和争议。但从短期看，对于今年下半年以及 2027 年，我们认为需求会保持强劲。因此，预计价格上涨会延续至今年下半年。我们在之前季度采取的定价措施，可能会在今年下半年、甚至明年开始体现。 2. 全球最大的晶圆代工企业近期也表示，将重新重视成熟制程和特色工艺，以服务客户；国内同行也希望增加产能。公司如何看待未来几年的成熟制程供需关系？公司将如何与同行形成差异化，并进一步提升盈利能力？ 答：我们比较幸运，仍有一座晶圆厂处于扩产过程中。因此，Fab 9A 的不断爬坡能够继续为我们带来较好的产能增量。 公司的优势所在我认为主要有两个方面。第一是技术能力，就国内而言，我们在很多领域处于行业领先水平，部分技术也与国际竞争对手相当。这为我们建设产能、服务客户奠定了坚实基础。 第二，自去年以来，尽管当时没有人预测到今年市场会上行，但我们一直保持稳定，并坚定地继续扩大产能。随着今年市场转向上行，这一稳步扩产的决策或战略已经在一定程度上取得了回报。 我认为，本轮需求回升将伴随带来小幅议价空间。不过需要提醒大家，这并不是 DRAM 市场那种倍数级上涨，我们讨论的仍然是百分比幅度。总体而言，市场正在向好；在可预见的时期内，至少今年下半年、甚至明年，我们应当仍能受益。 3. 中国最大的 DRAM 公司近期在亚洲上市，投资者对中国存储行业表现出很强的兴趣。与此同时，从全球来看，为存储厂商提供逻辑裸片代工服务已成为新的趋势。公司将如何受益于中国
--	---

	及全球的存储扩产？公司是否考虑与中国及全球的存储厂商合作，提供类似的逻辑裸片服务？ 答：存储器有不同类型。目前需求增幅最大的是 DRAM，其次是 NAND。我们不直接参与 DRAM 或 NAND，但在 NOR Flash 领域有相当规模的业务。今年该业务需求已经上升，预计今年下半年和明年仍将延续，因此我们能够受益于这一需求增长。 公司为特色工艺晶圆代工厂，我们的产品覆盖逻辑、模拟，以及 NOR Flash 等特色存储器。DRAM 需求增幅最大，说明 AI 正在推动整个半导体行业需求增加，这显然是好事，公司也受益于半导体整体需求增长。 具体到 DRAM 和 NAND，其技术方向正在发生变化：产品逐步把存储单元与外围逻辑分离为两个不同的裸片，再通过某种 3D 封装方式组合成完整产品。 在这种情况下，如果存储厂商希望投入更多精力、更加专注于纯存储单元，就可能把外围逻辑裸片交给大型晶圆代工厂制造。大型存储厂商可能会开始探索与逻辑晶圆代工厂合作，从而专注于其真正擅长的存储部分。 这一技术转型目前可能仍处于早期阶段，但整体方向正在形成，未来可能为逻辑晶圆代工厂带来新的需求。 4. 公司给出的第三季度指引显示增长稳健。能否拆分第三季度收入指引，说明其中有多少由 ASP 上涨驱动、有多少由产能扩张驱动？就产能扩张而言，第三季度和第四季度预计分别会新增多少产能？ 答：公司预计第三季度收入为 7.70 亿至 7.80 亿美元。收入增长主要来自 MCU；嵌入式非易失性存储器将继续强劲增长，增幅会达到两位数。独立式非易失性存储器在第三季度也会继续表现强劲，我认为这一趋势会贯穿全年并延续至 2027 年。 功率器件方面，尤其是低压产品，包括 MOSFET 业务以及部分中压产品，势头同样较强；IGBT 和超级结产品基本持平。 逻辑和射频方面，射频业务也将保持较强动能。此外，电源管理 IC 和模拟业务也有较强增长势头。尽管模拟业务目前规模仍小，但第三季度增长也相当强劲。 总体看，上述技术平台是主要驱动因素。从 ASP 与销量看，公司预计收入增长约 7%至 8%，其中约 60%来自 ASP，另有约 40%来自销量增长。 产能扩张方面，Fab 9A 将在第三季度达到全部规划产能，到
--	--

	下个季度，该厂所有设备都将安装完毕。我们会从第三季度开始全面装载产能，但产出可能要到第四季度或明年才会体现。到 2027 年，预计 Fab 9A 能够贡献一座完整晶圆厂的产出。
	5. 在需求强劲的情况下，公司能否在不同产品之间灵活切换产能？例如，能否把 CIS 产能转为存储器产品产能？哪些类型的产能可以进行这种转换？这种转换对下一季度或今年下半年的整体 ASP 会有什么影响？ 答：首先，产能在一定程度上具有可转换性，如果为某一技术平台建设了 1,000 片产能，按照一定转换比例，也可以用这些产能生产其他产品。 具体可转换多少，取决于相关技术平台。以 CIS 为例，其工艺流程与逻辑工艺非常接近。如果转向工艺流程接近逻辑的技术平台，很多产能都可以使用。我们通常把逻辑产品、CIS 和显示驱动类产品归为一组，因为它们在很大程度上可以相互转换。 如果把 CIS 产能用于 BCD 产品，仍有一定可转换性，但转换程度会降低；如果用于存储器产品，也存在一定可转换性，但可能进一步下降，因为部分存储器产品需要特有设备。很多时候，可转换性受各技术平台专用设备的限制。 在建设晶圆厂时，我们会管理产能的可转换性。晶圆厂显然不可能做到 100%通用，但我们会尽量提高通用程度，以便应对不同技术平台之间的市场需求波动。 目前，我们确实在最大程度上利用这种可转换性，但同时也需要为每类产品维持合理的产量，因为我们做的是长期业务。不能只看下个季度、甚至只看一年；其中包含一定程度的战略决策，以确保公司保持长期视角，不完全受短期因素驱动。 此外，我们也把价格作为管理需求的工具，用以调节不同技术平台之间的需求变化，使需求结构更好地匹配产能结构。总体而言，在整体需求紧张时，公司通常会全面提价，只是不同产品的提价幅度有所不同。
	6. 存储价格上涨可能会压制消费类产品的需求，但公司的消费类产品仍实现了环比增长。公司如何看待今年下半年消费相关产品的增长？ 答：年初时，大家开始意识到 AI 相关产品会有很高需求，同时业内也讨论 DRAM 价格上涨可能抑制消费需求，这一判断可能是成立的。部分终端市场，例如手机，今年显然会出现下

	滑。因此，我们原本预计消费领域的需求可能下降。 公司是一家覆盖不同市场领域的综合性晶圆代工厂。令我们略感意外的是，部分消费终端市场需求下降并未给公司带来预期程度的负面影响。一种可能是，公司作为晶圆代工厂，直接客户是设计公司；这些客户再把 IC 产品供应到不同终端市场。由于公司不直接向终端市场供货，直接客户可能在不同终端市场之间做了较好的管理，因此我们没有看到消费终端市场带来太大负面影响。 另一种可能是，即使消费终端市场短期需求略有下降，客户也不希望库存水平过低；他们仍希望建立一定库存，以应对未来可能不可避免的市场回升。 第三种可能与公司的产品和技术有关。正如前面所说，公司部分技术较强，产品主要处于中高端市场，而不是低端市场。低端市场受到的负面影响可能更大。 最终结果是，AI 相关产品的需求仍然强劲；在晶圆代工层面，公司尚未看到消费市场带来太大的负面影响。
	7. 请更新华力微收购的最新进展，以及收购完成后的技术路线图是怎么样？ 答：公司已在公告中更新进展，并已获得证监会批复，可以继续推进，正在正常按照程序推进。 我们预计这项收购将对财务报表产生非常积极的影响。交割完成后，华力微的业绩将并入公司财务业绩。 从产品来看，华力微与华虹宏力之间具有相当多的协同效应。通过技术共享，公司可在研发方面实现较多节省和协同。换言之，过去分别在华虹宏力或华力微开展的部分技术开发工作，现在可以合并；对于同样的研发投入，可以对应更大的制造规模，从而提高效率。 另一个帮助是，公司现在多了一座晶圆厂。对于某一技术平台而言，实际可用的整体制造规模扩大了。因此，公司能够承接产能需求更大的客户；在过去两个实体分开的情况下，尤其是华力微单独运营、规模不大的时候，这一点可能较难做到。 第三，华力微加入华虹宏力整体制造体系后，公司可以优化产能结构，例如决定不同技术平台应放在哪座晶圆厂，从而提高应对市场需求变化的能力。尤其在当前供应紧张的情况下，公司可以立即把无锡无法供应的部分技术平台转移到华力微。 总体而言，更大的规模可以带来研发节省、整体效率提升以及更大的采购量。各方面影响基本都是积极的。我们认为，

	这是一项非常好的举措。
	8. 公司如何看待 2027 年和 2028 年的需求持续性？这一轮周期是否可能在未来几年继续保持强劲？去年继续扩产是一个很好的决定。在需求强劲的情况下，公司是否需要在 2027 年和 2028 年进一步加快扩产？资本开支是否有进一步上调计划？ 答：公司希望继续稳步扩产，以便管理资本开支，同时维持目前的盈利能力。 短期市场需求强劲；对于今年下半年，大家看法较为一致，2027 年的共识也是需求会保持强劲。到 2028 年，业内开始出现一些争议，现在判断可能仍为时过早。但总体而言，在公司所参与的特色工艺市场，我确实看到了长期结构性增长逻辑。 这也是公司有信心继续扩产的原因。整体需求增长来自半导体的新应用，也来自部分行业参与者可能开始关闭一些 8 英寸晶圆厂。公司拥有三座 8 英寸晶圆厂，也会受益于部分行业产能退出。8 英寸和 12 英寸的情况不同。需求增长大多集中在 12 英寸。供应端方面，已很少有新增的 8 英寸产能，8 英寸供应甚至可能下降，12 英寸的需求则可能继续上升。 公司稳步扩产的战略，建立在这样一种信心之上：即使市场存在波动，整体方向仍然向上。相对于行业竞争对手，公司的技术能力将继续增强。公司具备规模、人才、过往业绩，以及在中国乃至全球的市场地位，我们认为自身能力会不断提升。 即使市场下行到来，我们也不害怕；公司仍会继续增长，并稳步增加产能。
	9. 公司收到约 2,500 万美元的设备政府补助。能否提供更多细节？此外，目前公司国产设备占比是多少？公司是否计划提高这一比例，预计会达到什么水平？ 答：这笔政府补助并非来自无锡，而是上海当地政府在第二季度向公司发放的补助。无锡部分很可能在 2026 年第四季度支付。 关于国产设备，中国国内设备行业逐年增强。作为总体趋势，公司预计越新的晶圆厂，国产设备占比会越高。
	10. 公司目前不同技术平台产品的交付周期分别是多少？哪些领域的周期在延长，哪些领域在缩短？具体而言，从收到订单到向客户交付产品，周期是否发生变化？

	答：从晶圆投入生产到完成所需的时间，显然取决于技术平台。有些工艺流程较长，有些较短。例如，功率器件的工序不多，如果加急，几周内即可完成。部分 MCU 产品有 30 至 40 层、甚至 50 至 60 层光罩，即使加急，也需要两个月。 晶圆在厂内流转的速度也取决于产能负载。晶圆厂负载很高时，设备作业前的排队时间会更长，因此平均流转速度会下降。我们通常会在晶圆厂内设置不同的优先级。对于 NTO 等首次导入的新产品，会给予较高优先级，使其能够很快产出。 对于量产产品，公司更倾向于最大化产出，而不是追求速度。总体而言，我认为没有产品需要超过一个季度。较快的产品可能需要一至两个月，具体取决于产品类型。 从收到订单到交付，周期没有显著变化。当需求较高、供应趋紧时，交付时间往往会略有延长。但公司会与客户协商；客户下单时，我们通常会承诺某一交付时间，如果客户同意且能够满足其要求，就按此推进。 如果客户有紧急需求，公司也可以提供支持。虽然不能覆盖全部订单，但一定比例的晶圆可以在需要时快速完成。 11. 公司未来两至三年的资本开支将重点投向哪些技术平台？ 答：公司的业务重点是特色工艺，而特色工艺在很大程度上由应用驱动，公司会跟随市场需求布局。 公司拥有四到五个大型技术平台，是因为这些领域具有较大的市场需求。例如，BCD 用于电源管理 IC；功率管理和功率器件服务于各类电气化及功率相关应用；MCU 方面，当前很多 AI 相关应用需要微控制器，汽车、尤其是新能源汽车也会使用大量微控制器。 CIS 在手机成为大型应用后就已存在较大需求，因为手机需要图像传感器。现在，安防需求、汽车、新能源汽车、自动驾驶汽车以及机器人等新兴应用也在推动 CIS 需求。 总体而言，公司会审视所参与的各项特色工艺，结合市场需求较高的领域与自身优势进行投入。例如，公司长期以来在 MCU 领域较强，而 MCU 也是增长领域，因此会投入较多产能；BCD 也是重点领域。 从过去几个季度的财务结果看，增速最高的主要是 MCU、BCD 以及 NOR Flash，公司会在这些领域投入更多。 CIS 和逻辑也是公司非常关注的领域。虽然其增速不及前述两至三个技术平台，但公司也会努力提升份额；对公司而言，它可能成为一个增长平台。
--	--

	公司新增的产能仍会围绕现有技术平台。与此同时，各技术平台本身也会演进。例如，MCU 可能从 55 纳米向 40 纳米发展，公司也会跟随这一变化。我们会观察市场的最佳切入点，并据此制定技术路线图，既跟随市场，也进入公司具有竞争优势的领域。
	12. 随着 Fab 9A 爬坡投产，今年下半年和明年的折旧费用大约是多少？ 答：今年下半年，8 英寸业务的折旧约为 5,500 万美元。第一座 12 英寸晶圆厂的折旧费用约为 2.5 亿美元；第二座 12 英寸晶圆厂约为 2.1 亿美元。以上为预测数据。 华力微方面，预计今年下半年折旧约为 3,000 万美元。该厂的大部分折旧期已经过去，目前预计年度折旧约为 5,000 万至 6,000 万美元，未来几年还会进一步下降。
	13. 上一次业绩会提到，公司正拓展硅光、硅中介层等互连解决方案。相关业务目前有何进展？哪些具体领域具有更强的增长潜力？ 答：公司是中国最大的特色工艺晶圆代工厂，同时也是中国第二大晶圆代工厂。在特色工艺领域，公司会跟随市场方向，也会进入自身具备实力或优势的领域；两者共同决定公司的布局。 AI 显然是增长驱动力。因此，凡是与 AI 应用相关、又属于特色工艺范围的领域，如果公司尚未进入，都会认真研究并决定是否布局。 公司已经参与电源管理 IC、MCU 和功率器件等领域。与光电子、硅光等方面已经有某种程度的参与和合作，但还非常早期。未来会进行更细致的研究与评估，希望可以扩大布局，进入更多类型的硅基器件领域，因为这是公司拥有专长的方向。 功率器件是另一个正在经历技术和市场转型的领域。此前主要以硅基器件为主，现在碳化硅器件也开始成为功率器件产品的一部分。一个模块通常同时包含硅基器件，并越来越多地包含碳化硅器件。 如果公司希望继续深耕功率器件，就必须研究这一方向，并评估能否提供更完整的产品组合。公司正在进行规划，正式宣布进入该领域前，还需要把若干事项准备到位；但公司的推进不会放缓。
	14. 公司来自北美和欧洲的收入增长非常强劲。能否进一步说明这

	两个地区的增长来源，例如是否来自服务器电源管理 IC、MCU 或其他产品？ 答：北美收入很大一部分来自 BCD 电源管理 IC；其中很多产品与 AI 服务器相关。由于这些产品直接用于 AI，因此收入出现了大幅增长。 欧洲方面，欧洲大型公司正在实施 “In China for China” 战略，其产品主要包括 MCU、智能卡以及部分功率器件。随着这些公司推进该战略，如果公司成为其在中国的首选合作伙伴就会带来增长。我们预计欧洲收入还会继续增长。 15. 市场一直在讨论设备供应非常紧张、材料价格上涨等问题。公司如何看待设备与材料的供应情况？ 答：设备供应正在趋紧，因为全球半导体厂商都在增加产能。无论海外供应商还是国内供应商，情况都是如此。具体表现是交付周期变长，但目前仍处于可管理水平。 公司从去年开始扩产，因此很多设备已在去年预订。到目前为止，我们没有看到很大的影响，但设备供应确实在趋紧。公司正与供应商及合作伙伴密切管理设备交付周期，尽量确保其不会影响整体产能扩张进度。截至目前，公司总体上能够做到这一点。 材料方面，存在少数个别情况。例如，受中东战争或其他因素影响，部分材料一度供应偏紧、价格上涨。氢气价格曾因战争出现短期飙升，但目前已经回落。 此外，部分金属价格也因整体通胀或供应状况而上涨。 但总体而言，影响并不显著。公司仍设法使采购价格保持平稳或下降；从供应商市场价格来看，整体环境对公司而言仍较为健康。
--	---